

導電性  
インク  
タイプ

標準フィルム基板仕様

狙いの市場

KPET-Cu 低抵抗銅ペースト  
基材：PI（ポリイミド）

高屈曲不要なFPC領域全般  
▶ センサー、フィルムヒーター

KPET-Ag 銀ペースト  
基材：PET（ポリエチレンテレフタレート）

大型化印刷  
▶ センサー、ワイヤレスイヤホン

KPET-S ストレッチャブル銀ペースト  
基材：PU（ポリウレタン）

ストレッチャブル基板  
▶ ウェアラブル（ヘルスケア・医療）、E-Textile

項目	一般FPC（比較対象）	KPET-Cu	KPET-Ag	KPET-S
基材種類	PI=25μm	PI=25μm	各種フィルム基材	各種フィルム基材
最小印刷間隔	L/S=50μm/50μm	L/S=100μm/100μm	L/S=300μm/300μm	L/S=200μm/200μm
印刷銅膜厚	18μm/35μm	15μm	20μm	20μm
比抵抗	2μΩ・cm	6μΩ・cm	20μΩ・cm	25μΩ・cm

## KPET-Cu 特徴

- 厚膜銅ペーストとしては業界トップクラスの低抵抗を実現
- 従来の印刷回路では困難なはんだ付けや金めつき処理が可能
- 印刷法にて、最小印刷間隔 L/S=100/100μmを実現
- 両面スルーホール対応（回路印刷と同時に形成）

### 製造工程

① 基材



② スクリーン印刷



③ キュア

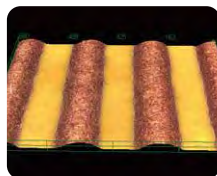


- スクリーン印刷、キュアのみで回路パターン完成
- 有害な廃液が発生せず、環境にやさしい
- 治工具はスクリーン製版のみ
- 片面20分、両面60分で完成
- エッチングライン不要、小スペース生産可能

### 製品写真



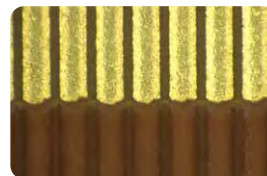
L/S=100/100



L/S=100/100  
3D表示



はんだ付け



金めつき



株式会社京写  
フィルム回路基板